

SAICAS Application Note

切片作製による化学分析測定 ① ～ 熱分析(TGA) ～

資料番号:SC0005 / 公開日:2021.01.12

<概要>

熱分析やSECなど試料を破壊して行う化学分析において、試験体における評価領域を限定するためには、対象領域の試料を回収する必要がある。

そこで今回は、切片作製機能にて耐候劣化させたPC樹脂を最表面から25 μm 深さまで5 μm 間隔で回収し、熱分析(TGA)を行った事例を紹介する。

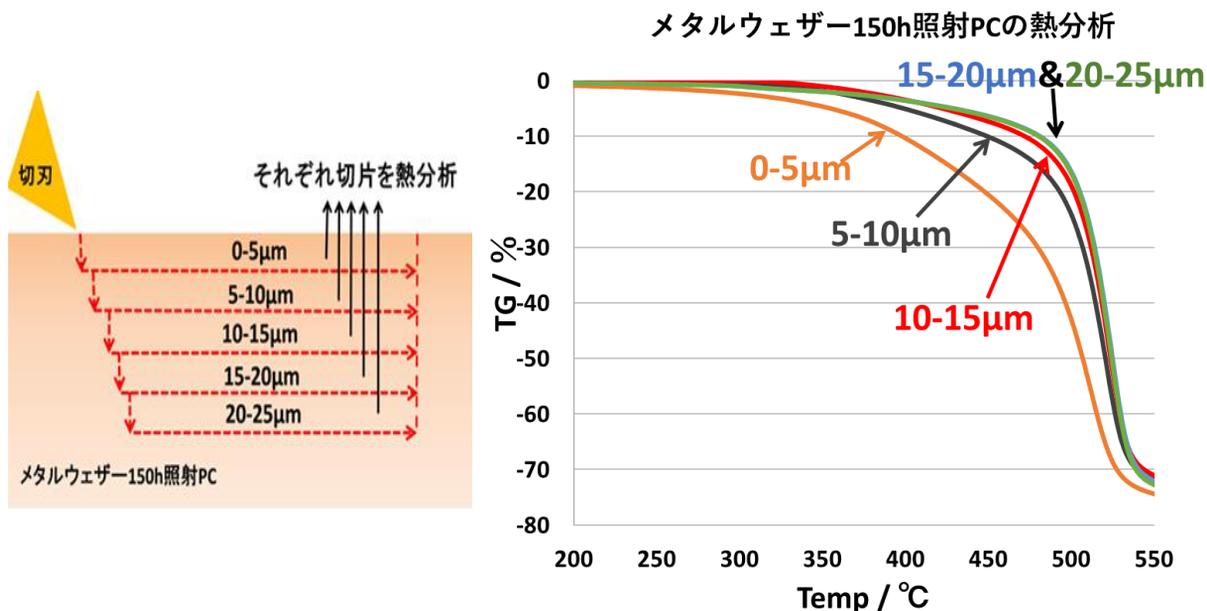
<試験>

試験体：ポリカーボネート(PC)樹脂 メタルウェザー150h照射

試験装置：SAICAS EN型 (切片作製機能付き)

切刃：ダイヤモンド切刃 (刃幅4mmスクイ角20° ニゲ角10° C面)

<結果>



測定結果に関するお問い合わせは、dawin@wintes.co.jpまで



ダイプラ・ウィンテス株式会社
DAIPLA WINTES CO.,LTD.